



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D202038 S

(45)公告日：中華民國 109 (2020) 年 01 月 11 日

(21)申請案號：108301849D01

(22)申請日：中華民國 108 (2019) 年 04 月 02 日

(51)LOC.(11)Cl.：13-99

(30)優先權：2018/10/12 日本 2018-022471

(71)申請人：日商華爾卡股份有限公司 (日本) VALQUA, LTD. (JP)

日本

(72)設計人：吉田延博 YOSHIDA, NOBUHIRO (JP)；中川一平 NAKAGAWA, IPPEI (JP)

(74)代理人：洪武雄；陳昭誠

(56)參考文獻：

TW D127505

TW D149670

TW D163769

TW D164826

TW D164827

TW D166713

TW D180129

TW D183422

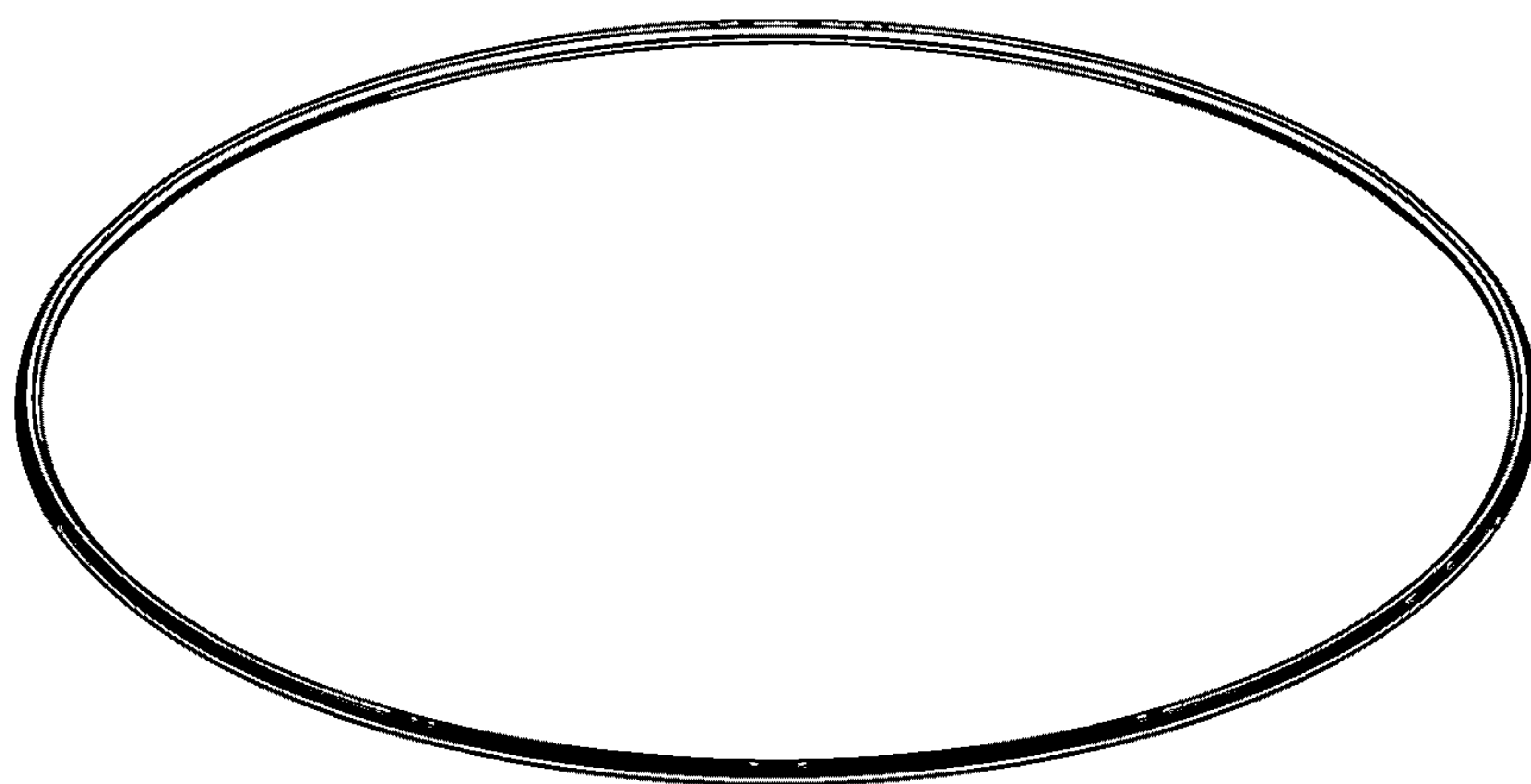
審查人員：徐銘峰

圖式數：8 共 9 頁

(54)名稱

半導體製造裝置用密封材

代表圖：



【立體圖】

D202038

【衍生設計說明書】

【中文設計名稱】 半導體製造裝置用密封材

【英文設計名稱】 SEAL MEMBER FOR USE IN SEMICONDUCTOR

PRODUCTION APPARATUS

【物品用途】

【0001】 本物品係一種半導體製造裝置用密封材，適合使用於例如CVD或乾蝕刻裝置等半導體裝置。如顯示本物品之使用狀態的參考圖所示，本物品之半導體製造裝置用密封材係插入設於半導體製造裝置之第1構件的溝部內，而用以將第1構件與第2構件之間密封者。

【設計說明】

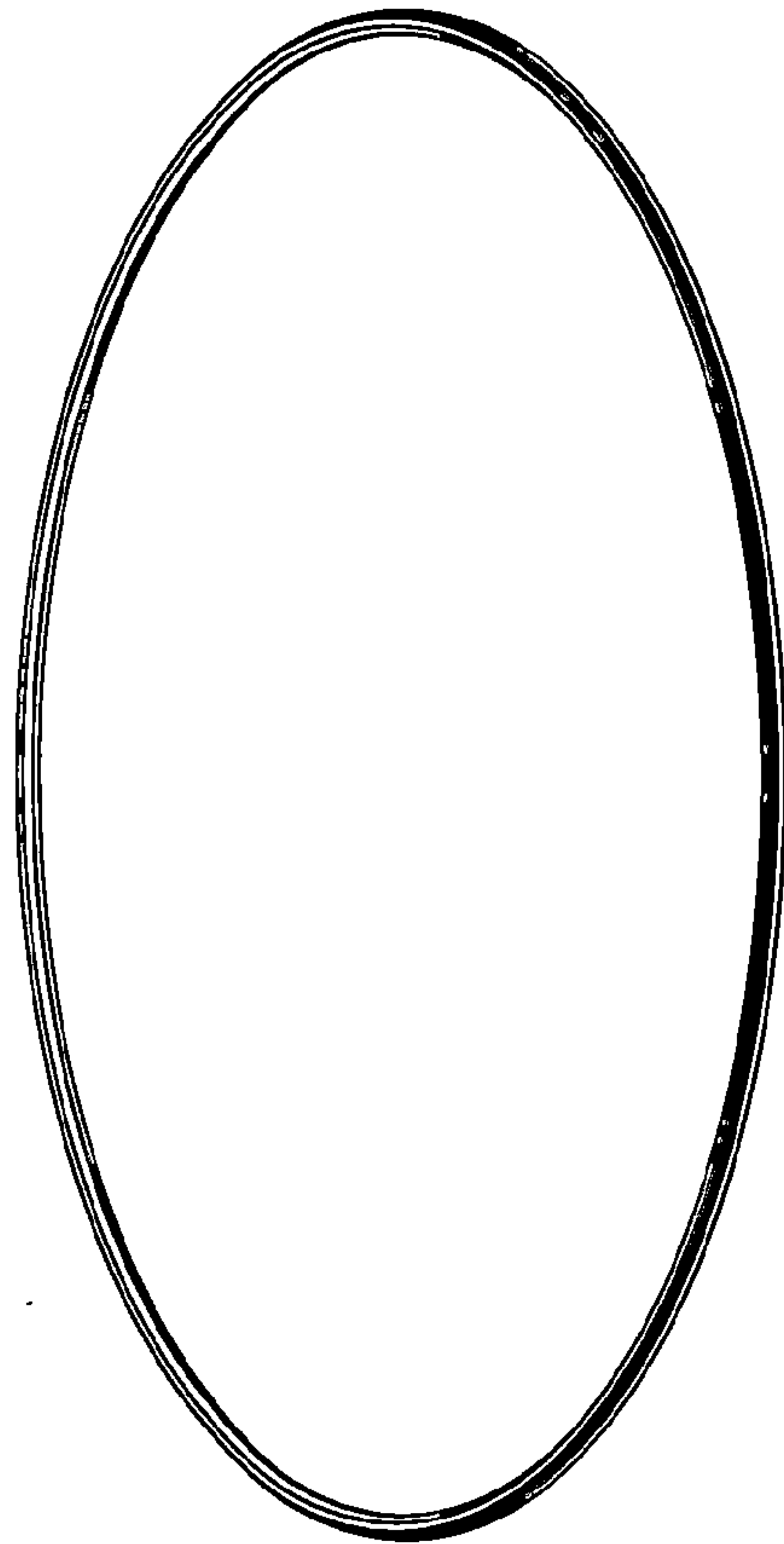
【0002】 本設計係關於第 108301849 號專利申請案之衍生設計。

【0003】 後視圖與前視圖相同，故省略之。左側視圖與右側視圖相同，故省略之。

【0004】 A-A剖面圖係俯視圖中之A-A線處的剖面圖。

【0005】 B-B放大剖面圖係將A-A剖面圖中之B-B線部分予以放大顯示的圖。

【衍生設計圖式】
(指定代表圖)



【圖體立】

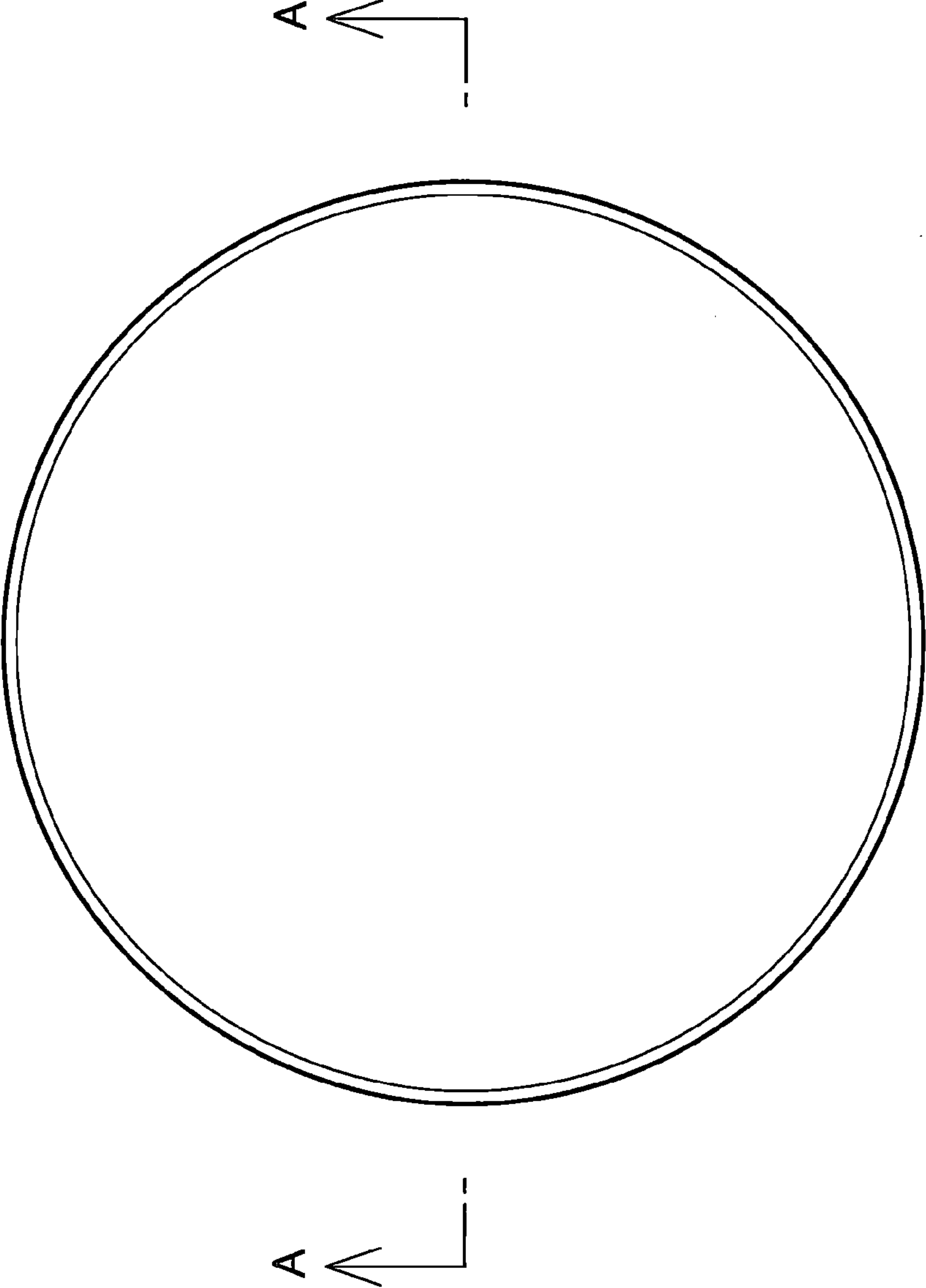
、
、
、



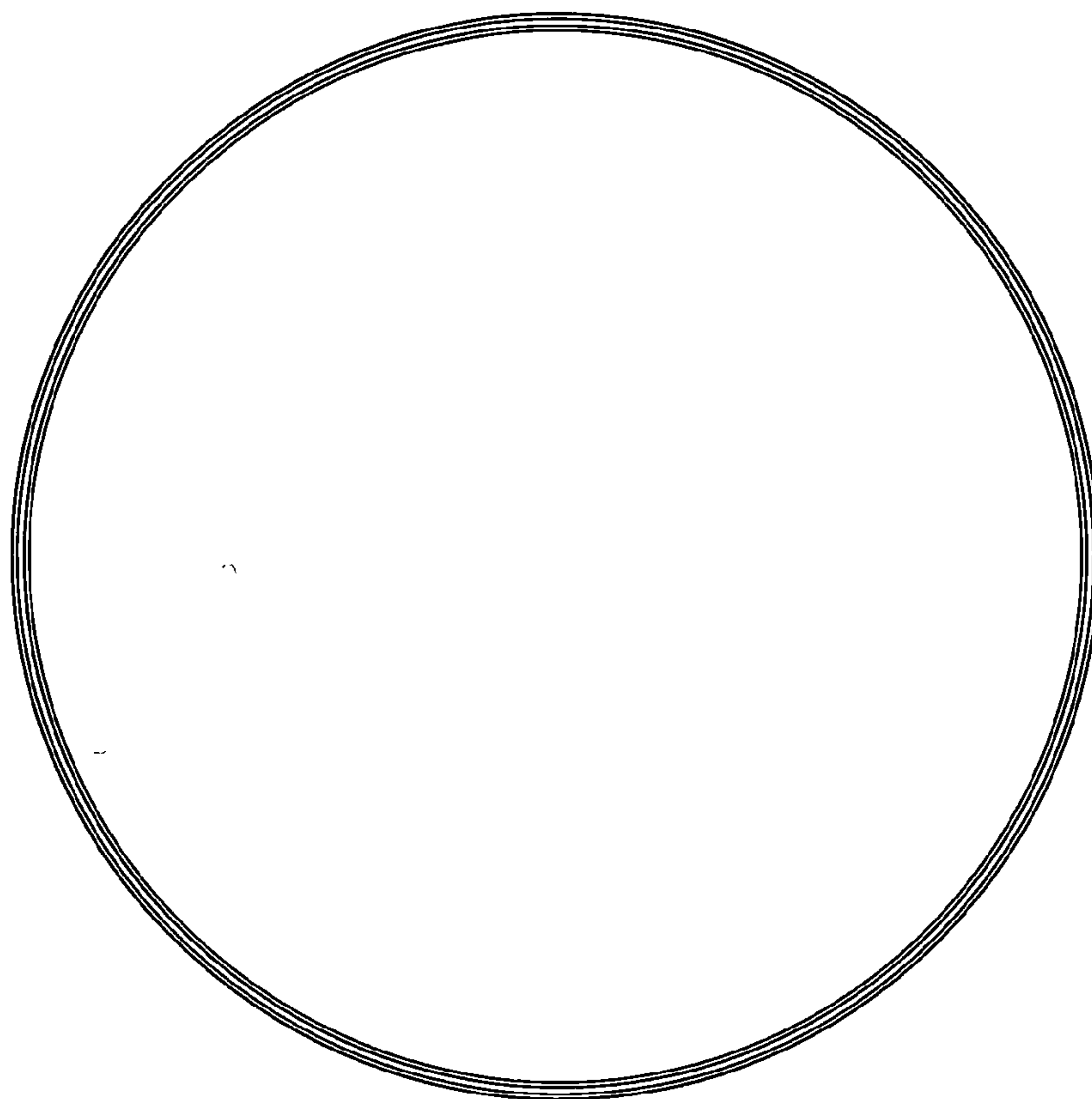
【前視圖】



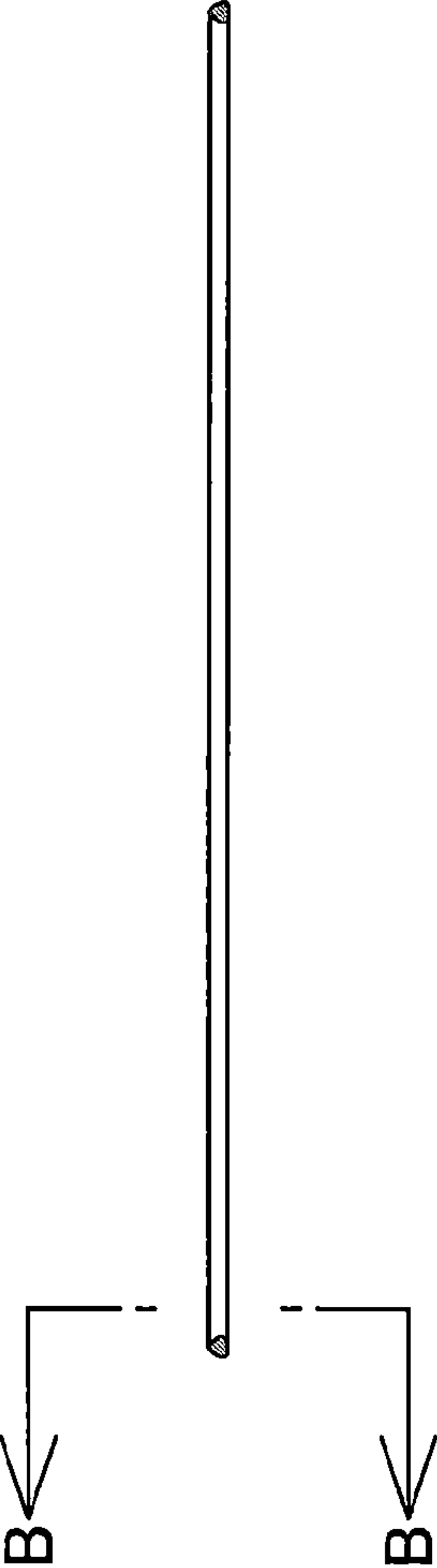
【右側視圖】



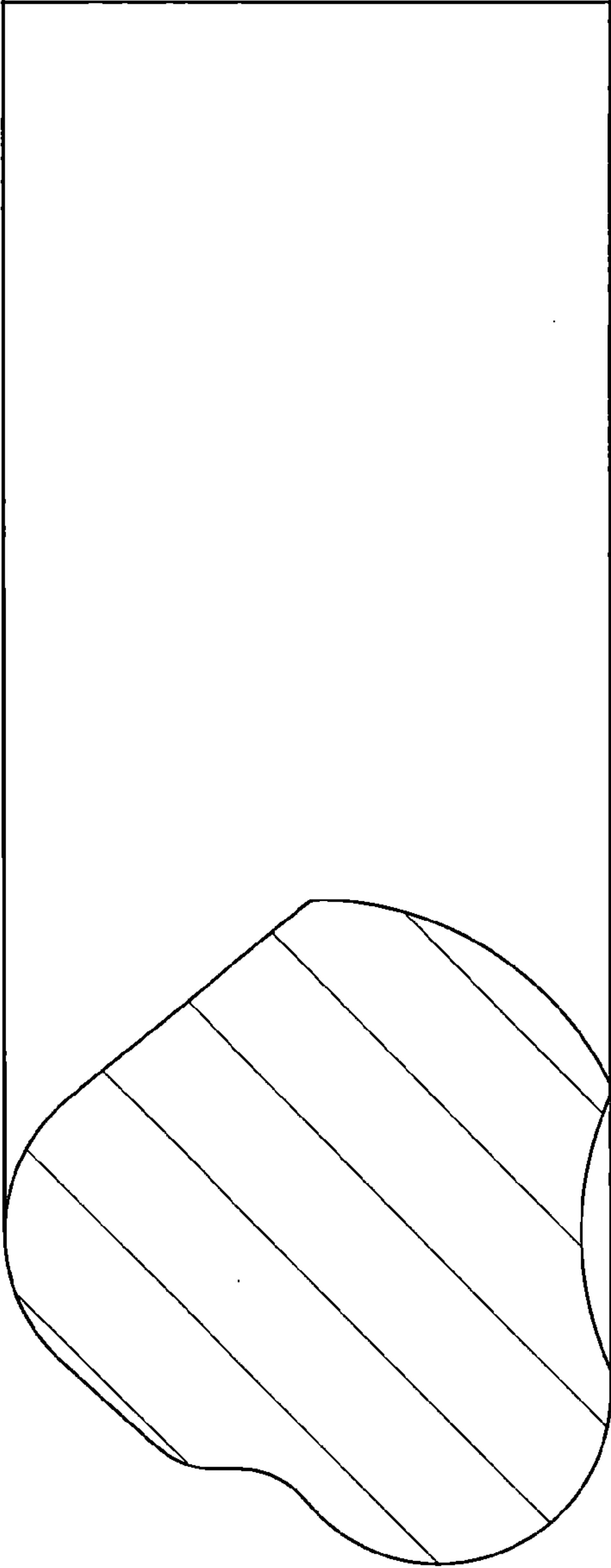
【俯視圖】



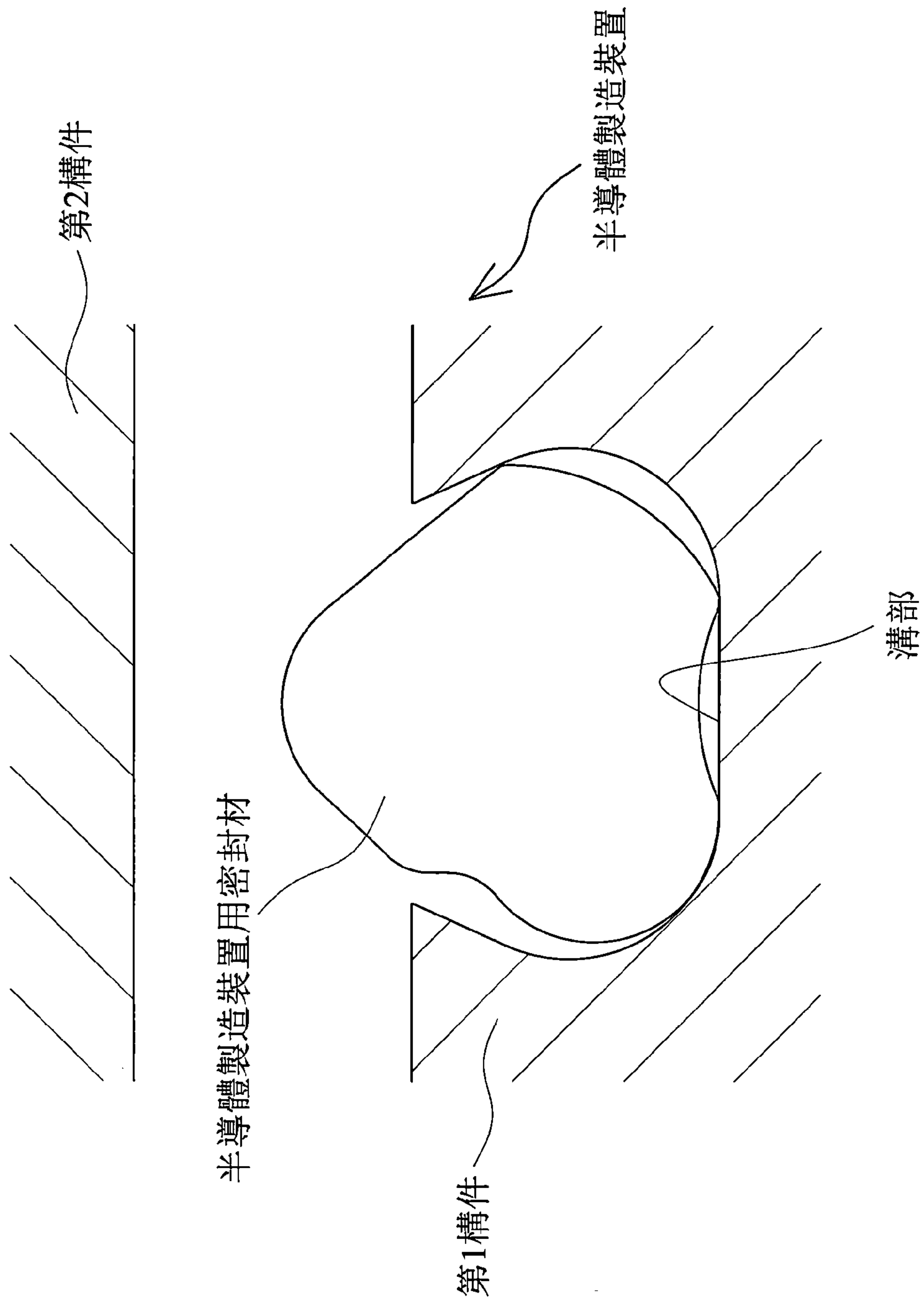
【仰視圖】



【A-A剖面圖】



【B-B放大剖面圖】



【顯示本物品之使用狀態的參考圖】